

一般社団法人 半導体産業人協会
理事長 内海 忠
講演企画委員長 内山 邦男

2019年9月度 SSIS フォーラム開催案内

平素、SSIS フォーラムにご出席いただき、厚くお礼申し上げます。

今後、大きな発展が見込まれるAI/IoT時代において、様々なAIエッジ端末やセンサ内蔵IoT端末を実現する実装技術の需要がますます高まります。今回のフォーラムでは、コネクテックジャパン株式会社の平田勝則代表取締役を講師に迎え、世界初となる80～170℃の極低温実装技術(MonsterPAC)と、これを武器にして新ビジネスモデルOSRDA(Outsourced Semiconductor Research, Development & Assembly)を展開し世界に挑戦している状況をご紹介します。市場の動向ならびに現在取り組んでいる次世代開発新技術のご紹介も交え、今後の実装技術について論じて頂きます。

皆様のご参加をお待ちしております。

■講演タイトル

変える力とつなぐ力でIoT実装に革命を
～極低温実装がひらく、新ビジネスモデルへの挑戦～

■講師

平田 勝則 様
(コネクテックジャパン株式会社 代表取締役)



< 講演要旨 >

今後、世界中で新たなマーケットが創出され、自動車産業を越える事業拡大が予想されるIoT市場において、世界初となる80～170℃の極低温実装技術(MonsterPAC)を武器に、新ビジネスモデルOSRDA(Outsourced Semiconductor Research, Development & Assembly)を展開し、世界に挑戦している状況を、市場動向ならびに現在取り組んでいる次世代開発新技術のご紹介も交え、ご紹介いたします。

< 開催要領 >

1. 日時 2019年9月26日(木) 17時30分～20時
2. 場所 林野会館(文京区大塚3丁目、地下鉄丸ノ内線「茗荷谷」下車徒歩7分)
3. プログラム
17時30分～18時45分 講演 (5Fホール)

講師 平田 勝則 様
(コネクテックジャパン株式会社 代表取締役)
変える力とつなぐ力で IoT 実装に革命を
～極低温実装がひらく、新ビジネスモデルへの挑戦～

19 時～20 時 交流会 (6F 604 号室)

4. 参加費

SSIS 会員 3, 000 円 (交流会込み)
一般 4, 000 円 (講演のみ)
6, 000 円 (講演および交流会)

参加費は当日会場にて申し受けます。なお、会員でない方は当日入会申込が可能です。
募集人員 80 名 (会場の都合により定員を超えた時点で募集を打ち切らせて頂きます)

5. 参加申し込み

SSIS 事務局行 (FAX : 03-6457-3246 E-Mail : info@ssis.or.jp でも承ります)

=====

SSIS フォーラム 参加 申込 票

9 月 26 日(木)の SSIS フォーラムに出席します。

お名前 :

電話 :

所属 :

区分 : SSIS 会員 []

一般 [] 講演のみ参加、[] 講演および交流会参加

=====

SSIS フォーラムの情報および

協会の活動の最新情報は、

ホームページでご覧いただけます。 <http://www.ssis.or.jp>

一般社団法人 半導体産業人協会

TEL : 03-6457-3245 FAX : 03-6457-3246

事務局 (info@ssis.or.jp)
